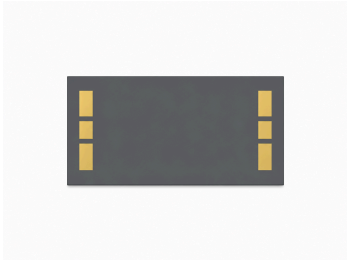


6000–18000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.8 dB (typisch); Begrenzungspegel: 16.5 dBm (typisch) / 17.5 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 42 dBm (Maximum) (τ = 300 μ s; D = 30%). Chipabmessungen: 1.6 $\times$ 0.8 $\times$ 0.1 mm.



RF-Kennwerte · TA = +25 °C

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Betriebsfrequenz	-	6000	-	18000	6000–18000	MHz
Einfügedämpfung	-	-	0.8	-	-	dB
Eingangs-VSWR	-	-	1.6	-	-	-
Ausgangs-VSWR	-	-	1.6	-	-	-
Begrenzungspegel	-	-	16.5	17.5	-	dBm
Maximale gepulste Eingangsleistung	-	-	-	42	τ = 300 μ s; D = 30%	dBm

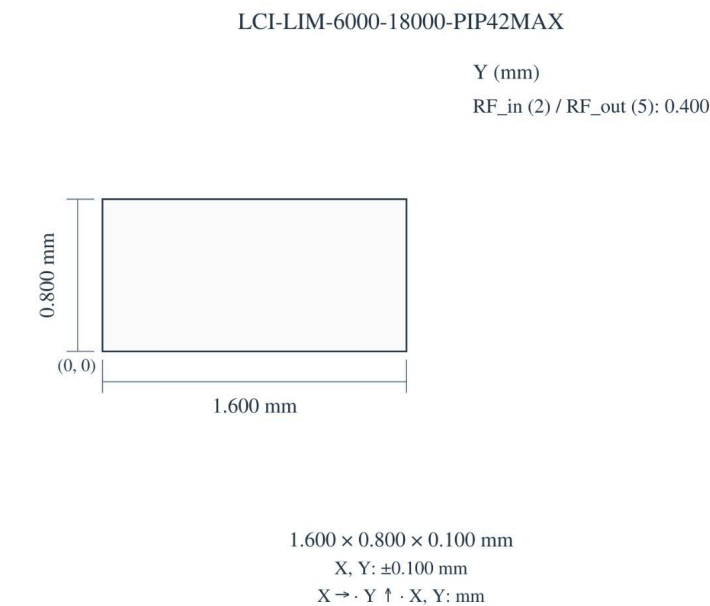
Umgebungsbedingungen

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Betriebstemperatur	-	-55	-	125	°C

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	1.6 × 0.8 × 0.1	mm

Mechanische Maßzeichnung



Alle Maße in mm [in].

Bondpad-Belegung

Anschlüsse	Symbol	Funktion	Hinweise
2	RF_in	RF-Eingang	50 Ω
5	RF_out	RF-Ausgang	50 Ω
1, 3, 4, 6	GND	Massepad für die Nadelprüfung	-

Aktueller Publikationsstand · 1.3 · 2026-10-27. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.2.

Chipintegration und Bias-Reihenfolge

DC-Sperrkondensatoren sind am Ein- und Ausgang integriert.

Geltungsbereich der mechanischen Referenz

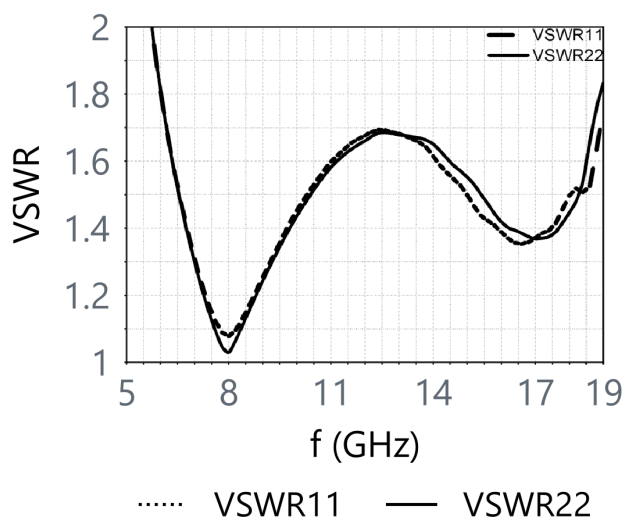
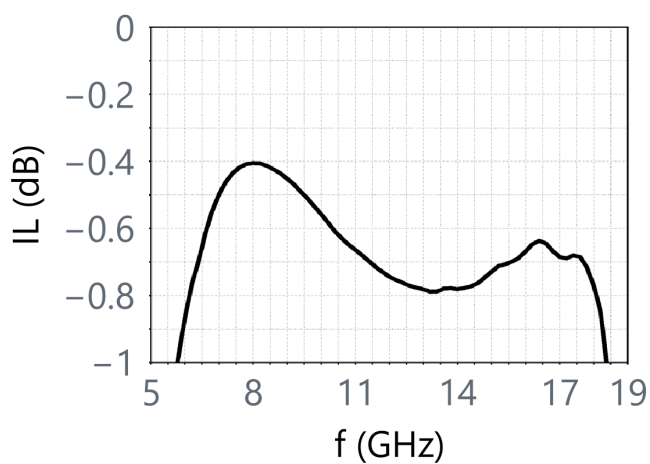
Maßskizze nach Quelldokumentation in mm. Teilinformationen; keine vollständige Fertigungs- oder Bonddrahtzeichnung.

Kennlinien

Diagramme aus dem ursprünglichen Datenblatt. Beachten Sie die bei jeder Abbildung angegebenen Betriebsbedingungen.

Ein- und Ausgangsanpassung; Einfügedämpfung.

Angabe auf der Quellseite: TA=+25°C. Die dargestellten Original-Diagrammflächen samt Kurven und Raster bleiben erhalten; nur äußere Achsen und Anordnung sind neu gesetzt. Messdatenreihen oder verdeckte Zustände werden nicht rekonstruiert. Der vollständige ursprüngliche Frequenzachsenbereich von 5–19 GHz bleibt erhalten.



[Quelle](#)

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.